

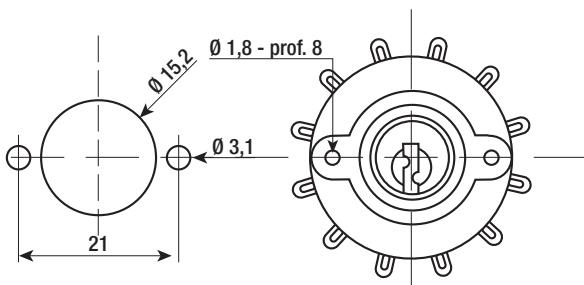
CSV 12



Passation des commandes : CSV 12 Order procedure: CSV 12

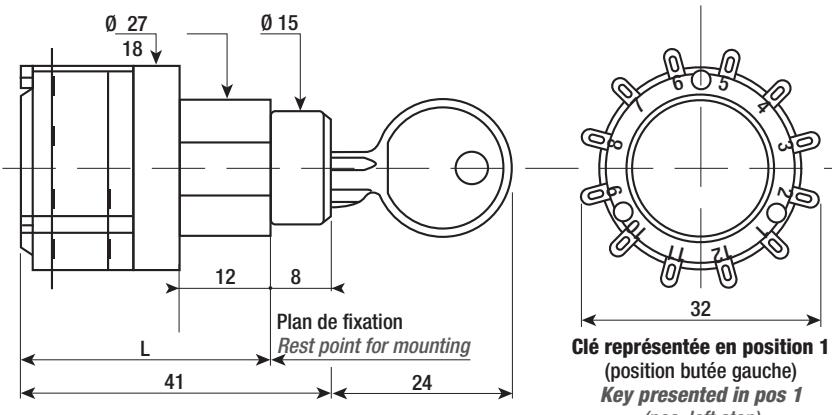
Ecart angulaire x° Index angleButée à (x) position ou sans butée (o) Stop at (x) pos. or without stop (o)Nombre de galettes (1 ou 2) Number of wafers (1 or 2)Code interne IEC Internal IEC codeNombre total de circuits (1-12) Total number of circuits (1-12)Court-circuit au passage (à préciser éventuel) Make before break (to be specified)

Clé retirable en position (à préciser) Key to be withdrawn in pos. (to be specified)



Perçage sur panneau
Panel drilling

Cote L : Length L :
1 Galette : 34 1 Wafer : 34 mm
2 Galettes : 44,5 2 Wafers : 44,5 mm



Caractéristiques générales General characteristics

2 galettes maximum • 2 wafers maximum

Epaisseur maximum de panneau • Maximum thickness of panel 8 mm

Durée de vie (nombre de commutations)

100 000

Nombre d'insertions et d'extraction de clé possible

Possible insertions and extraction of a key 20 000

Matériaux plastiques employés Noryl pour le corps D.A.P. pour la galette

Plastic materials used Noryl for the body D.A.P. for the wafer

Contacts en argent massif titré • Solid silver contacts

Contacts dorés G sur demande
Gold plated contacts G on request

Résistance des butées • Resistance of stop 10 kg.cm

Diamètre des trous de câblage • Terminal holes for wiring 1,3 mm

Livré avec 2 clés • Delivered with 2 keys

Masse environ 24 g pour 1 galette
Weight about 24 g with 1 wafer

Avec ou sans court circuit au passage (C.C.P.)

Shorting or non-shorting contacts

Caractéristiques électriques Electrical characteristics

Ecart angulaire 30°	de 1 circuit 12 positions à 6 circuits 2 positions par galette
Index angle 30°	1 circuit 12 positions to 6 circuits 2 positions per wafer
Ecart angulaire 60°	de 1 circuit 6 positions à 4 circuits 2 positions par galette
Index angle 60°	1 circuit 6 positions to 4 circuits 2 positions per wafer
Ecart angulaire 90°	de 1 circuit 4 positions à 3 circuits 2 positions par galette
Index angle 90°	1 circuit 4 positions to 3 circuits 2 positions per wafer
Intensité de coupure maxi • Cut-off current max.	1 A
Intensité de passage maxi • Change-over current max.	3 A
Tension de coupure maxi • Cut-off voltage max.	100 V
Tension de passage maxi • Change-over voltage max	300 V
Résistance de contact • Contact resistance	< 10 mΩ
Tension de claquage entre lames et circuits (Vcc) Rupture voltage between plates and circuits (Vdc)	2000
Résistance d'isolement entre lames et circuits Insulation resistance between plates and circuits	> 1.10 ⁹ MΩ

Désignation / Designation:

N° de plan ou référence / Design N° or reference:

Client / Customer:

N°